

5047

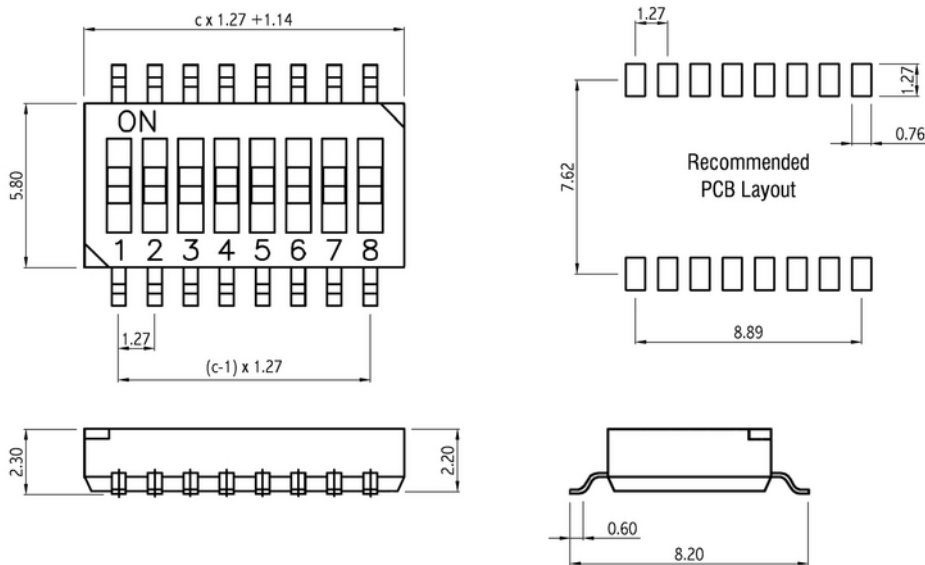
SMT-DIP-Schalter RM 1,27mm - Bauhöhe 2,3mm SMT DIP-Switches, 1.27mm Pitch - 2.3mm Profile

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Gehäuse: Schwarz, Hebel: Weiß
Colour	Black housing, white actuators
Kontaktmaterial	Schaltkontakt: Kupferlegierung
Contact Material	Lötkontakt: Messing
Contact Material	Switch: Copper Alloy
Contact Material	Terminal: Brass
Kontaktbelastbarkeit	50V _{DC} , 100mA in Ruhe
Contact Rating	24V _{DC} , 25mA im Schaltvorgang
Contact Rating	50V _{DC} , 100mA in steady situation
Contact Rating	24V _{DC} , 25mA at mate and break
Kontaktoberfläche	Vergoldet
Contact Surface	Gold plated
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 100mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 100mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ
Insulation Resistance	> 100MΩ
Spannungsfestigkeit	300V _{AC}
Test Voltage	300V _{AC}
Temperaturbereich	-40°C ... +85°C
Temperature Range	-40°C ... +85°C
Elektrische Lebensdauer	> 1000 Zyklen/Schalter
Electrical Life	> 1000 cycles/switch
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Zyklen/Schalter
Mechanical Life	> 1000 cycles/switch
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



Series

5047

Circuits*

08

02/04/06/08

Packaging*

FST

ST
TR
FST
FTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes

TR Tape & Reel / Tape & Reel

FST In Stangen, mit Abdeckfolie / In tubes, top film tape sealed

FTR Tape & Reel Verpackung, mit Abdeckfolie / Tape & Reel Packing, top film tape

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

